

2024 年 10 月 17 日

各 位

会 社 名 ニデックアドバンステクノロジー株式会社
代表者名 代表取締役社長 山崎 秀和
所 在 地 京都府向日市森本町東ノ口 1 - 1
ニデックパーク C 棟

TPCA Show TAIPEI 2024 への出展について

ニデックアドバンステクノロジー株式会社（以下、当社）は、2024 年 10 月 23 日(水)～10 月 25 日(金)に台北南港展示センターで開催される電子回路製造企業が集結する国際展示会「TPCA Show TAIPEI 2024」に出展します。



今回の展示会は「Innovative AI in PCB」をテーマに、AIトレンドに焦点を当て、欧州、米国、アジアなどから610を超える企業が集結、1600を超えるブースが設けられます。

当社からは、AI 半導体関連製品を中心に微細化や実装の複雑化が進んでいるハイエンド回路基板に対応した最新の光学検査技術・電気検査技術・プロービング技術を紹介いたします。

また、近年注目を集めているパワー半導体に関しても最新技術と製品を紹介いたします。

〈出展概要〉

- ・会期： 2024 年 10 月 23 日(水)～10 月 25 日(金)
- ・会場： 台湾台北南港展示センター（TaiNEX 1）
- ・ブース： M-1326
- ・公式サイト： <https://tw.tpcashow.com/en/>

〈主な展示内容〉

- ・HDI/PCB 基板向け導通/短絡検査装置「GATS/STAR REC シリーズ」
- ・アドバンスドパッケージ対応導通/短絡検査装置「GATS78 シリーズ」
- ・高精度光学式ウェハ検査装置「NSW シリーズ」

- ・高密度基板対応光学式 2D/3D 検査装置「RSH シリーズ」
- ・高速/高精度検査テスト「R-5940」
- ・高速/高精度マルチファンクションテスト「R-700 シリーズ」
- ・最先端デバイスに対応最小ピッチ 60 μm 「MEMS FLEX プローブカード」
- ・IGBT/SiC パワーモジュール検査装置「NATS シリーズ」
- ・xEV モーター用テストベンチ「TDAS シリーズ」
- ・xEV モデリングシミュレーター「E-Transport Simulator」

今後も当社グループは、検査装置の技術を応用した様々な関連商品の内製展開により、モータの省エネ化を含めたシステム全体の最適化を図ることで電力の消費を抑え、地球環境への負荷低減に貢献する革新的なソリューションを提案していきます。